产品简介

- KXS160-H是一款双组分加成型有机硅导热灌封胶。该产品粘度低，流动性好，使用简单方便；其固化物具有优异的导热性，阻燃性，可在-60℃~+220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及散热作用。

产品特点

- 高导热
- 可室温或加温固化
- 阻燃-完全符合UL94-V-0认证
- 耐高低温，可耐受-60~220℃
- 优异的机械性能

典型性能

检测项目		参考标准	单位	数值	
固化前性能	外观	目测	/	A组分	灰色流体
				B组分	白色流体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组分	4,000-6,000
				B组分	4,000-6,000
	密度	ASTM D792	g/cm³	A组分	1.85±0.05
				B组分	1.85±0.05
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1:1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	4,000-6,000	
	可操作时间	ASTM D2196	min	20-60	
	初固时间	ASTM D2240	h	2-4	
	固化时间	ASTM D2240	h	@25℃	24
			min	@80℃	30-60
固化后性能	外观	/	/	灰色固体	
	硬度	ASTM D2240	Shore-A	≥40	
	密度	ASTM D792	g/cm³	1.85±0.05	
	导热系数	ASTM D5470	W/m.k	≥0.8	
	介电强度	ASTM D149	kV/mm	≥15	
	体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	$>1*10^{13}$	
	阻燃等级	UL-94	/	V0	

联系我们：张 艳：138-5168-3378；荣 岩：180-6607-5325；
田晓冰：152-5095-2541；许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

使用方法：

- **混合前**：先将A、B组份分别搅拌均匀。
- **混合**：按重量比A：B=1：1，准确称量两组份放入干净的容器内搅拌均匀。
- **脱泡**：可自然脱泡和真空脱泡，自然脱泡：将混合均匀的胶静置10-15分钟，真空脱泡：真空度为0.08-0.1MPa，抽真空5-10分钟。
- **灌注**：应在操作时间内将胶料灌注完毕，否则影响流平。灌封前基材表面保持清洁和干燥。
- **固化**：室温或加热固化均可。温度升高，固化速度变快。气温低时，建议采用加热方式固化。

注意事项：

- 远离儿童存放。
- 胶料密封贮存。混合好的胶料一次用完，避免造成浪费。
- 本品属非危险品，但勿入口和眼。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会不固化：
  - N、P、S有机化合物。
  - Sn、Pb、Hg、As等元素的离子性化合物。
  - 含炔烃及多乙烯基化合物。

✓ 为了避免上述现象，所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

包装规格、储存与运输：

- **包装规格**：
  - 2kg/套（A组份：1kg/罐；B组份：1kg/罐）；
  - 50kg/套（A组份：25kg/桶；B组份：25kg/桶）；
  - 其他规格可以根据客户需求进行订制；
- **储存**：最佳储存温度：≤30℃，有效期： 12 个月。
- **运输**：此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。